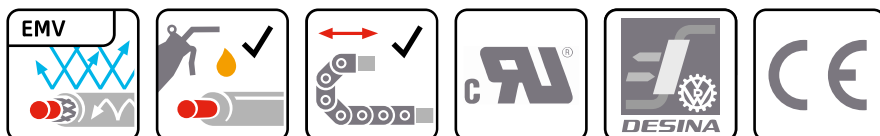


Schleppkettenleitung FACAB BUS DeviceNet EFK



Leiter-Material:	Cu, verzinkt
Leiter-Klasse:	KI.6 = feinstdrätig
Schirm über Verseilelement:	Kunststoffbeschichtete Al-Folie + Cu-Beilaufitze, verzinkt
Schirm über Verseilung:	Cu-Geflecht, verzinkt
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	violett
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-25 - +80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	-30 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt:	8 x DA
Biegeradius, bewegt:	15 x DA
Wellenwiderstand:	120 Ohm
Nennspannung U:	300 V
Aderkennzeichnung:	ws/bl + rt/sw

Verwendung: DeviceNet(TM) Leitungen sind für den Anschluss an das von Allen Bradley (Rockwell Automation) entwickelte Bussystem vorgesehen. Die Ausführung mit den größeren Querschnitten wird üblicherweise als Backbone- (Trunk) Leitung verwendet, die Variante mit den geringeren Querschnitten als Stichleitung (Drop) für den Anschluss diverser Endgeräte.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften FACAB BUS DeviceNet EFK

Artikelbezeichnung	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg/km]
DeviceNet (TM) FRNC 1X2X AWG 18 + 1X2X AWG 15 EFK Thick VL UL-Style CMX 75 C CL2X	12,3	94	197
DeviceNet (TM) FRNC 1X2X AWG 24 + 1X2X AWG 22 EFK Thin VL UL-Style CMX 75 C CL2X	7,3	36	65

DA	Außendurchmesser ca.
Cu	Kupferzahl (de)
G	Gewicht